

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2021-003

中微半导体设备（上海）股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，并于 2020 年 9 月 16 日公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项；2020 年 10 月 10 日，公司披露了《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》。

公司于 2021 年 1 月 20 日对公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、募集说明书的补充

第一章 发行人的基本情况

序号	补充位置	补充内容
1	“一、股权结构、控股股东及实际控制人情况”之“（二）股权结构”	更新截至 2020 年 9 月 30 日公司前十大股东情况
2	“四、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施”之“（一）科技创新水平”	更新截至 2020 年 12 月末公司持有专利数量

第二章 本次证券发行概要

序号	补充位置	补充内容
1	无	

第三章 本次募集资金使用的可行性分析

序号	补充位置	补充内容
1	“一、本次募集资金投资项目的的基本情况”之“（一）项目基本情况”之“3、科技储备资金”	公司关于使用募集资金实施“对外投资并购项目”的承诺事项
2	“一、本次募集资金投资项目的的基本情况”之“（四）项目的实施准备和进展情况”之“1、中微产业化基地建设项目”	更新取得募投项目土地使用权的进展情况
3	“一、本次募集资金投资项目的的基本情况”之“（四）项目的实施准备和进展情况”之“2、中微临港总部和研发中心项目”	更新取得募投项目土地使用权的进展情况
4	“一、本次募集资金投资项目的的基本情况”之“（六）公司的实施能力”之“1、技术与人才储备”	更新截至2020年12月末的公司研发人员情况
5	“一、本次募集资金投资项目的的基本情况”之“（六）公司的实施能力”之“2、研发技术产业化的能力”	更新截至2020年12月末公司持有专利数量
6	“三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性”之“（一）土地取得情况”	更新取得募投项目土地使用权的进展情况
7	“三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性”之“（二）项目备案情况”	更新募投项目项目备案的进展情况
8	“三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性”之“（三）环境影响评估备案情况”	更新募投项目环评备案的进展情况
9	“四、募集资金用于研发投入的情况”	更新截至2020年12月末公司持有专利数量

第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

序号	补充位置	补充内容
----	------	------

1	“一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划”	更新资产结构模拟测算结果与报告期末财务数据
---	--------------------------------	-----------------------

第五章 与本次发行相关的风险因素

序号	补充位置	补充内容
1	“一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素”之“（四）毛利率水平波动甚至下降的风险”	更新报告期内主营业务毛利率数据
2	“一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素”之“（六）政府补助与税收优惠政策变动的风险”	更新报告期内计入当期损益的政府补助数据
3	“一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素”之“（八）国际贸易摩擦加剧风险”	补充美国国防部网站 2021 年 1 月 14 日将中微开曼加入中国涉军企业名单的消息及其影响
4	“三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素”之“（二）募投项目支出增加导致利润下滑的风险”	更新资产结构模拟测算结果

第六章 与本次发行相关的声明

序号	补充位置	补充内容
1	无	

除上述补充外，发行人对募集说明书中少量文字描述等非实质性内容进行了修订。

二、其他申请文件的修订

发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告相应也进行了更新修订。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日